



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20080814002A
2008 年 9 月 29 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 ビジネスオペレーションズ部
カスタマドキュメント マネージャ 牧 達郎 (牧)

SOIC 8/14Dパッケージ部製品 組立サイト追加変更のご案内
(認定済 37 製品への追加 16 製品認定の連絡)
(初版 PCN20080814002 2008 年 8 月 27 日発行)

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきまして下記にご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願ひ申し上げます。

敬具

－ 記 －

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)	☒ Final notice
変更概要	Design/Specification	☐ Design ☐ Electrical ☐ Mechanical
	Wafer Fab	☐ Site ☐ Process ☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site ☐ Process ☐ Material
	☒ Assembly	☒ Site ☐ Process ☒ Material
	Test	☐ Site ☐ Process
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling ☐ -
変更内容	下記変更について、認定済 37 製品への追加認定 16 製品の連絡になります。 SOIC 8/14D パッケージ部製品 組立サイト追加変更 現行：TI-Taiwan 変更後：TI-Taiwan 及び TI-Mexico	
対象製品	対象製品リスト参照	
変更時期	2009 年 1 月上旬の出荷より予定しています。 (サンプルは、2008 年 11 月上旬を予定しています。)	
品質認定試験	☐ 計画	☒ 終了
製品表示	☐ 変更無し	☒ 変更あり
備考	-	

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。
また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更内容

内容: 下記変更について、認定済37製品への追加認定16製品の連絡になります。追加認定品の出荷は、本通知日の90日以降に実施いたします。本通知の変更時期は、追加認定品にのみ適用されます。弊社 HPA(ハイパフォーマンシアナログ) SOIC 8/14Dパッケージ一部について、現行TI-Taiwanにて製造していますが、これに加えTI-Mexicoサイトでの製造を追加し認定しました。この変更に伴い、いずれも既に量産に適用しているものになりますが、下記部材の使用とさせていただきます。尚、出荷梱包部材につきましては、追加認定したサイトで現在使用しております部材の使用とさせていただきます。今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差)、外観、動作特性、品質、信頼性への影響はありません。

変更内容

組立製造サイト
マウントコンパウンド

現行

TI-Taiwan
Hitachi EN4088Z

変更後

TI-Taiwan、TI-Mexico
Hitachi EN4088Z、QMI 505MT

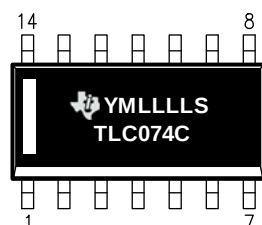
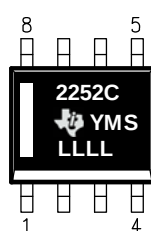
理由: 製品安定供給確保の為

対象製品リスト

対象製品名				
□: 認定終了品 ■: 追加認定品				
TLC074CD	TLC274CDG4	TLC27L4CDR	TLC3931DRG4	TLE20721D
TLC074CDG4	TLC274CDR	TLC27L4CDRG4	TLC556CD	TLE20721DG4
TLC074CDR	TLC274CDRG4	TLC3391D	TLC556CDG4	TLE20721DR
TLC074CDRG4	TLC277CDR	TLC3391DG4	TLC556CDR	TLE21421DR
TLC2252CDR	TLC277CDRG4	TLC3391DR	TLC556CDRG4	TLE21421DRG4
TLC2252CDRG4	TLC27L4ACD	TLC3391DRG4	TLE20271DR	TLV22521DR
TLC22541D	TLC27L4ACDG4	TLC374CD	TLE20271DRG4	TLV22521DRG4
TLC22541DG4	TLC27L4ACDR	TLC374CDG4	TLE20371DR	TLV2462CDR
TLC22541DR	TLC27L4ACDRG4	TLC374CDR	TLE20371DRG4	TLV2462CDRG4
TLC22541DRG4	TLC27L4CD	TLC374CDRG4	TLE2062A1DR	
TLC274CD	TLC27L4CDG4	TLC3931DR	TLE2062A1DRG4	

製品表示

製品捺印にて、サイトコード“S”の記載が“T”(TI-Taiwan)に加え、“M”(TI-Mexico)となります。図-1を例としてご参照ください。



YM = Year/Month Code
LLLL = Assy Lot
S = Site Code
T : TAI (TI-Taiwan)
M : FMX (TI-Mexico)
| = Pin 1 Stripe

YM = Year/Month Code
LLLL = Assy Lot
S = Site Code
T : TAI (TI-Taiwan)
M : FMX (TI-Mexico)
| = Pin 1 Stripe

図-1. 製品捺印の表示例

信頼性試験

信頼性試験結果

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	-	終了	2008 年 6 月 23 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qualification Device:		TLC274CDR	TLV2462CD	
Die Rev/ Size(mils):		F / 109.0 X 69.0	A / 49.0 X 49.0	
Wafer Fab Site:		DFAB	DFAB	
Technology/ Fab Process:		CMOS / LinCMOS_5/5	BiCMOS / LBC3S	
Assembly Site:		FMX	FMX	
Package/ Pin Count:		D / 14	D / 8	
Mold Compound:		LOC GR825-73B	LOC GR825-73B	
Mount Compound:		QMI 505MT	QMI 505MT	
Bond:		TS-0.95Au	TS-0.95Au	
L/F Composition/ Finish:		Cu / NiPdAu	Cu / NiPdAu	
MSL:		LEVEL1-260C	LEVEL1-260C	
Flammability Rating:		UL 94 V 0	UL 94 V 0	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		TLC274CDR	TLV2462CD	
Manufacturability	Per site spec	Approved	Approved	

信頼性試験結果

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	-	終了	2004 年 6 月 15 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qualification Device:	SN74HC4060D		TL598CD	
Die Rev/ Size(mils):	G / -		F / 80.0 x 80.0	
Wafer Fab Site:	SHE		SHE	
Technology/ Fab Process:	CMOS / HCMOS		Bipolar / JI Bipolar	
Metal1-2:	TiW/AICu2%		TiW/AICu2%	
Passivation:	10KACN		10KACN	
Assembly Site:	FMX		FMX	
Package/ Pin Count:	D / 16		D / 16	
Mold Compound:	LOC GR825-73B		LOC GR825-73B	
Mount Compound:	QMI 505MT		QMI 505MT	
Bond:	TS-0.95Au		TS-0.95Au	
L/F Composition/ Finish:	Cu / NiPdAu		Cu / NiPdAu	
MSL:	LEVEL1-260C		LEVEL2-260C	
Flammability Rating:	UL 94 V 0		UL 94 V 0	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		SN74HC4060D	TL598CD	
** Steady-state Life Test	150C, 300 hrs	120/0	120/0	
** Biased HAST	130C/85%RH, 96 hrs	78/0	78/0	
** Autoclave	121C, 96 hrs	231/0	231/0	
** Temperature Cycle	-65/150, 1000 cyc	231/0	231/0	
** Thermal Shock	-65/150, 1000 cyc	231/0	231/0	
** Storage Bake	170C, 420 hrs	231/0	231/0	
Lead Pull to Destruction	Per MFG spec	66/0	66/0	
Flammability	UL 94V-0	15/0	15/0	
	UL-1694	15/0	15/0	
	IEC 695-2-2	15/0	15/0	
X-RAY	Top side, per mfg spec	15/0	15/0	
Moisture Sensitivity	Level 1/260C	12/0	12/0	
** Preconditioning at Jedec 1, 260C				